

# PBGA封装基板BT板料三菱HL832NXA基材多层超薄半导体材料IC载板PCB

产品名称	PBGA封装基板BT板料三菱HL832NXA基材多层超薄半导体材料IC载板PCB
公司名称	深圳嘉圳电子科技有限公司
价格	25.00/个
规格参数	嘉圳:IC载板 BGA:PBGA 深圳:宝安
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新沙路星际大厦3A09
联系电话	18680337466 18680337466

## 产品详情

尊敬的客户，

感谢您对我们深圳嘉圳电子科技有限公司的关注和支持！本次我们向您推荐的是一款优质的PBGA封装基板BT板料三菱HL832NXA基材多层超薄半导体材料IC载板PCB。该产品价格仅为25.00元每个，具备出色的性能和可靠的质量，可满足您的多样化需求，进一步提升您的产品竞争力。

首先，让我们为您展示一下PBGA封装基板在现代电子技术中的重要性。作为一种高性能封装技术，PBGA广泛应用于各类电子产品，如计算机、通信设备、光学设备等。它与IC载板相结合，能够提供出色的电气连接功能和热耦合性能，有效保护芯片和电路的稳定运行。

BT板料（Bismaleimide Triazine）作为一种特殊的高性能基材，具有良好的机械性能和电气性能，非常适合用于制作PBGA封装基板。它具有优异的耐高温、耐湿热和抗蠕变性能，能够保证电路板在复杂工作环境下的稳定性。此外，BT板料还具备良好的机械加工性能，可满足不同尺寸和形状的要求。

我们的合作伙伴——三菱电机公司，为我们提供了HL832NXA基材。这种基材是一种多层超薄半导体材料，采用了先进的工艺和技术，并经过严格的品质检测，以确保其出色的性能和可靠性。HL832NXA基材具有极低的介电常数和介电损耗，能够提供稳定的信号传输特性，使IC载板更加高效和可靠。

嘉圳电子多年来一直专注于IC载板的研发、生产和销售，拥有先进的生产设备和丰富的经验，为客户提供高品质、高可靠性的产品和个性化的解决方案。我们的工程师团队不断创新，致力于为客户提供更好的服务和支持。

作为深圳宝安的本土企业，我们深知客户对产品质量和交货周期的重要性。因此，我们在生产过程中严格控制质量，保证产品符合guojibiaozhun，并通过精细管理和高效运作，确保按时交付，满足客户需求。

在此，我们诚挚地邀请您与我们合作，购买我们的PBGA封装基板BT板料三菱HL832NXA基材多层超薄半导体材料IC载板PCB。无论是在计算机硬件、通信设备或光学设备等领域，我们相信我们的产品将为您的业务带来更多机会和成功。

如需进一步了解产品详情或订购，请随时与我们联系。我们期待与您携手合作，为您提供zuijia的解决方案和最优质的服务！

谢谢！

深圳嘉圳电子科技有限公司

地址：深圳宝安XX路XX号

网址：>